**國立陽明交通大學專利申請暨研發成果產出聲明書**

專利提案編號：

立書人為國立陽明交通大學(以下簡稱本校)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系/所之\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_□教授/□副教授/□助理教授/□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_等研究團隊成員，於在校期間所研發產出之技術「 」(以下簡稱本專利)，同意以本校名義申請各國發明專利，並遵守對應之專利費用負擔比例，聲明如下：

1. 立書人知悉依據本校「研發成果與專利申請管理辦法」第7條第9項規定「創作人因構想揭露書為不實陳述，包含但不限於計畫來源、新穎性等事項之陳述，或其他可歸責於創作人之個人因素，而無法獲得專利權時，或專利事務所向官方提出正式申請前，由創作人自行撤案，專利費用概由創作人自行負擔；本校已支付之專利費用，創作人亦應返還」。
2. 立書人保證該研發成果產出之計畫來源如專利構想揭露書所載:(於下表擇一簽名後，不得再行更改)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫來源 | 國家科學及技術委員會 | 經濟部 (計畫執行期間由計畫  100%支付) 註1 | 其他無補助計畫 |
| **請計畫主持人 (或創作人代表，若為無計畫則由創作人代表簽名)依計畫性質於空格中簽名** |  |  |  |
| 費用補助方式 | 地區 | 補助機關/學校 | 立書人 |
| 推薦通過 | 台、美 | 100% | 0% |
| 其他國家及地區 (獲證後由學校支付100%) | 70% | 30% |
| 立書人自費 註2 | 所有國家及地區 | 0% | 100% |

註1：經濟部計畫結束後，將依本校「研發成果與專利申請管理辦法」第7條由創作人(立書人)分攤費用。

註2：立書人自費案，全體立書人則須依比例分攤負擔專利費用(包含領證及維護年費)。

**國立陽明交通大學專利申請暨研發成果產出聲明書(續頁)**

1. 立書人保證其所提供之本專利申請資料正確無誤，並無任何冒充、抄襲、模仿、影射或其他不實情形。
2. 立書人同意遵守本校專利申請相關規範並配合本校辦理一切專利申請、推廣運用之必要程序。
3. 立書人聲明若有違反上述一至四點，導致本校產生相關額外費用支出或遭致第三人求償，立書人同意自行負擔該相關額外費用及賠償金。
4. 本校之專利逾當時補助機關規定應維護之年限，而未曾技術移轉或現無技術移轉者，得由產學運籌中心視其情形提請評量會決議，經公告3個月且無人請求受讓時，並經政府機關同意後放棄維護。
5. 立書人同意若本專利為立書人自行出資委派事務所申請，立書人會將答辯、領證、維護及終止維護等各專利程序副本知會承辦人。※如為國家科學及技術委員會計畫衍生之成果欲終止維護，請務必於終止前六個月通知研發處，俾便校方通報國家科學及技術委員會。
6. 若為國家科學及技術委員會計畫成果，立書人同意負責或督促計畫主持人登錄國家科學及技術委員會科技研發成果資訊系統(STRIKE)完成填寫研發成果基本資料。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **立書人** | **戶籍地址** | **身份證字號** | **簽章** |
|  |  |  |  |

(所有專利申請案皆需簽署本聲明書)

**專利申請之構想揭露書(I)**

本 校 編 號：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

申請日期： 年(YY) 月(MM) 日(DD) (Docket Number)

（Application Date）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.專利申請名稱  Title of Invention | 中 文(Chinese) | | | | | | | | | | | |
| 英 文(English) | | | | | | | | | | | |
| 2.本申請案之聯絡人  Contact Persons | 1 | 第一聯絡人  Main Contact Person | | | 姓名  Name |  | | | 電話  Tel | | 實驗室Lab. | |
| 服務  單位Organization |  | | | 辦公室Office | |
| 職稱  Title |  | | | 傳真  Fax | |  | |
| 電子  信箱  E-mail |  | | | 手機  Mobile | |  | |
| 2 | 第二聯絡人  Secondary Contact Person | | | 姓名  Name |  | | | 電話  Tel | | 實驗室Lab. | |
| 服務單位Organization |  | | | 辦公室Office | |
| 職稱  Title |  | | | 傳真  Fax | |  | |
| 電子  信箱  E-mail |  | | | 手機  Mobile | |  | |
| 3.本申請案所屬補助計畫  Research Project under which This Invention Is Developed(請確實填報不得更改) | 補助單位 Project Sponsor | | 計畫名稱  Project Title | | | | 計畫編號  Project Number | | | | | 補助金額  Grant funds |
|  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  |
| 4.有關本申請案最早的紀錄  First Lab Records | 日期  Date | | | | 年(YY) 月(MM) 日(DD) | | | | | | | |
| 簿號頁數Locations | | | | 研究紀錄簿號： 頁數：  Laboratory notebook No.: Page: | | | | | | | |
| 5. 創 作 人  Inventors | 1 | 姓名(代表人)  Name  (Proj. Leader) | | 中 文(Chinese) | | | | 國籍  Nationality | | □中華民國Taiwan, R.O.C.  □雙重國籍 Dual citizenship \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他Others  國別\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 英 文(English) | | | |
| 身份證字號  ID No | |  | | | |
| 服務單位Organization | |  | | | | 職稱  Title | |  | | |
| 電子郵件信箱E-mail | |  | | | | 電話Tel | |  | | |
| 永久地址  Home Address | |  | | | | | | | | |
| **是否具雙重職員身份**  **Dual Role** | | (ex:榮總VGHTPE、北市醫TCH、陽明附醫NYCUH…）  □否(No) □是(Yes)， / 科室(Department) | | | | | | | | |
| 2 | 姓名  Name | | 中 文(Chinese) | | | | 國籍Nationality | | □中華民國Taiwan, R.O.C.  □雙重國籍 Dual citizenship \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他Others  國別\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 英 文(English) | | | |
| 身份證字號  ID No. | |  | | | |
| 服務單位Organization | |  | | | | 職稱  Title | |  | | |
| 電子郵件信箱  E-mail | |  | | | | 電話  Tel | |  | | |
| 永久地址  Home Address | |  | | | | | | | | |
| **是否具雙重職員身份**  **Dual Role** | | (ex:榮總VGHTPE、北市醫TCH、陽明附醫NYCUH…）  □否(No) □是(Yes)， / 科室(Department) | | | | | | | | |
| 3 | 姓 名  Name | | 中 文(Chinese) | | | | 國籍 Nationality | | □中華民國Taiwan, R.O.C.  □雙重國籍 Dual citizenship  國別 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □其他Others  國別\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 英 文(English) | | | |
| 身份證字號  ID No. | |  | | | |
| 服務單位Organization | |  | | | | 職稱  Title | |  | | |
| 電子郵件信箱  E-mail | |  | | | | 電話  Tel | |  | | |
| 永 久 地 址  Home Address | |  | | | | | | | | |
| **是否具雙重職員身份**  **Dual Role** | | (Ex:榮總VGHTPE、北市醫TCH、陽明附醫NYCUH…）  □否(No) □是(Yes)， / 科室(Department) | | | | | | | | |
| 6.成果歸屬  IP Owner | NYCU( )% / \_\_\_\_\_\_\_\_( )% / \_\_\_\_\_\_\_\_\_( )% | | | | | | | | | | | |

備註：如欄位不敷填寫，請自行複製增加使用。If the blank field is not enough to fill in, please add it yourself.

備註：除事先另有約定者，本專利權人為國立陽明交通大學，專利發明人等同意遵照政府與本校獎勵、權益收益分配及相關法規。

Unless agreed in advance, the patentee is the National Yang Ming Chiao Tung University, and the inventors agree to comply with the government laws and the university’s regulations.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **創作人**  **(Inventor)** | **貢獻比例**  **(intellectual contribution to the invention ratio)** | **簽章**  **（Signature）** | **日期**  **(Date)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

備註:所有發明人貢獻比例須為整數，且加總為100%。

Intellectual contribution to the invention ratio must be an integer, 100% in total

**專利申請之構想揭露書(II)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.專利申請名稱  Title of Invention | 中 文(Chinese) | | | |
| 英 文(English) | | | |
| 8.專利類別  Type of Patent | ■發明(Invention) | | | |
| 9.申請國家及理由詳述  Applied-For Country (ies) and Reasons | □ 中華民國(TW) □ 美國(US)  □ 其他國家：  申請理由詳述: | | | |
| 其他說明：  若勾選其他國家之申請，請明確填寫國家別(請勿以區域代表申請國家，例如：歐盟) | | | |
| 10.本申請案是否已公開？  Is the Invention Disclosed to the Public? | □是(Yes) □否(No)  (論文口試未有簽署保密同意書及張貼非公開發表之告示，則視同公開)  If the thesis oral examination does not sign the confidential disclosure agreement and post a non-public announcement, it will be deemed to be published.  若是，請註明發表之時間及場所（If yes, please show the date and location）    **(論文口試、公開場所之簡報、網路公佈等皆視同公開，會導致新穎性喪失，若因創作人陳報不實造成損失，將依本校「研發成果與專利申請管理辦法」第7條第9項規定辦理。)**  Thesis oral examination, public presentations, online publications, etc. are all deemed to be published, which will cause the loss of novelty.  If losses are caused by false reports or misrepresentation by the inventors, they will be subject to the university`s regulations.  若否，預計公開之日期（If no, please indicate the anticipated disclosure date）    公開之目的（請在適當空格內勾選）（The purpose of disclosure）  □學術論文或刊物發表（Publication） □學術研討會發表（Symposium）  □展覽（Exhibition） 　 　 □其他（Other）   * 為維持申請專利內容之新穎性，請勿在申請前，發表相關內容之論文。若已先行發表，**請檢附已發表之相關文獻**，並註明其發表日期及與專利內容之相關程度。   For the purpose of patent application（to maintain the novelty of your findings）,please do not publish any of your invention before application, If you have already revealed part of them to the public, please attach your publications and write down the date and their relevance to your current invention disclosure.   * 申請人保證上述資料正確無誤，倘有不實，願受法律之懲罰。   The undersigned agree to accept punishments provided for in laws in case of any deceptive activities. | | | |
| 其他說明：   1. 我國專利法：凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得相關專利：(1)申請前已見於刊物或已公開使用者。(2)申請前已為公眾所知悉者。 2. 本案申請前，因為有(1)研究、實驗(2)陳列於政府主辦認可之展覽會者、及(3)非出於申請人本意而洩漏者等情事，其事實發生之日起一年內申請者，不受上述第一項各款規定之限制。   註：各國專利權責機關皆有類似之寬限期規定，實際申請作業上，除了台灣與美國申請案外，其他國家之申請案一般都有較嚴苛之寬限標準。不建議申請前，先發表技術。 | | | |
| 11.檢索關鍵字  Keywords |  | | | |
| 12.相關先前技術調查情形  Existing Relevant Technologies | 1. | 已檢索之專利資料(Patent Numbers & Publication Date)：  *\*請先自行上網檢索。* | | |
| 2. | 相類似技術或其他已發表之文獻(Similar Technology or Literature)： | | |
| 3 | 習知技術之說明及其缺失(Description of the Prior Art and the Defect)： | | |
| 13.本申請案之特色  Advantages of the Invention | 1. | 本申請案之發明領域及創作目的(Field and Purpose of the Invention)： | | |
| 2. | 本申請案所欲解決之問題及其技術特點(Advantages of the Invention)： | | |
| 14.本申請案可能應用之範圍  Applicable Fields of the Invention | 1. | 可能應用之產業(Applicable Industries)： | | |
| 2. | 可能應用之產品(Applicable Products)： | | |
| 3. | 可能授權之公司及聯絡人(Potential Licensees & Contacts )： | | |
| 公司名稱 | 聯絡人 | 聯絡方式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 15.較佳實施例之說明(Description of the Preferred Embodiments)：  *\*舉出至少一項關於本發明之較佳實施例(可配合圖示說明)，使熟習該技術者能了解其內容並可據以實施。* | | | | |
| 16.本申請案所欲保護的專利範圍(Claims)：  *\*請列出本技術在方法/構造/裝置/形狀/成份/組成上與習知技術(prior art)之比較，具有創新、進步或功效等獨特技術部分，得以行使排除他人侵權及請求賠償損害之專有權利。* | | | | |
| 17.舉發侵權之方法(How to Define and Discover Infringements)：  *\*請依本提案技術特徵及功能，說明如何針對產品/或服務鑑定是否侵權？* | | | | |
| 18.中文技術摘要(Description of Invention in Chinese)：  *\*請以簡明文字說明有關本發明/創作之內容特點。* | | | | |
| 19.英文技術摘要(Description of Invention in English)：  *\*為辦理專利申請時所需資料，請務必提供。* | | | | |
| 20.技術分析報告摘要(Description of Technology Analysis)：  *\*請針對本表第***12-1***項與第***12-2***項所檢索之專利或文獻資料，盡量詳細分析***每一篇***之技術特性，且與本申請案之比較，及本申請案之***技術優勢***。****(若創作人團隊有類似技術也請比較其差異)***  *\*\****敬請務必檢附此報告摘要***，此將作為校內技術審查與專利申請說明書之內容。* | | | | |
| 21.市場分析報告摘要(Description of Market Analysis)：  *\*請針對本表第***09***項所填寫之國家別，提供明確資料(申請人可以提供其他紙本資料代替本分析報告摘要)*   1. *為何申請該國之詳細理由，請條列詳述。* 2. *該申請案之技術或產品預估在該國之重要性(市場佔有率、產品之競爭成本……)。* 3. *申請該國是否有現存或潛在之競爭優勢？* 4. *其他有利申請該國之因素 (如有技轉/合作廠商支持、衍生公司新設之市場據點……) 。*   *\*\****敬請務必檢附此報告摘要***，並將作為校內技術審查與評量申請國家別之主要決定因素之一。* | | | | |